



TIF®100N 8085-06 是一款兼具优异散热性能与可靠结构支撑能力的导热垫片。能够在填充界面间隙、建立高效热传导通路的同时，为堆叠或邻近的电子元件提供稳固的机械支撑，满足长期耐用性需求。此外，材料本身具备低介电特性，可有效降低高频信号传输过程中的能量损失，保障信号完整性。

特性

- 》低介电常数，有效降低信号损耗
- 》优异的热传导率
- 》耐候性与耐老化出色
- 》优秀的长期可靠性

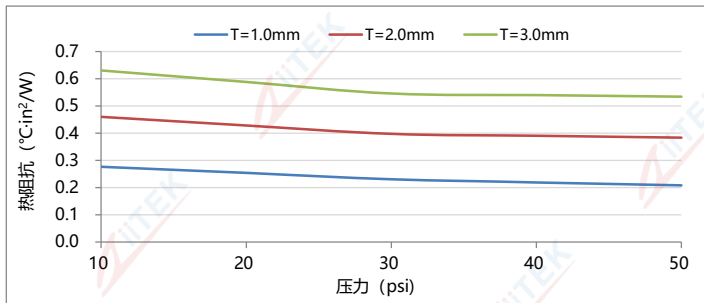
应用

- 》毫米波雷达
- 》半导体微波组件
- 》5G基站
- 》射频功率放大器
- 》高性能计算

TIF®100N 8085-06 系列特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	白色	目测
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	-
厚度范围 (inch/mm)	0.012~0.120 0.30~3.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	85	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	1.6	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200	-
击穿强度 (V/mm)	≥3000	ASTM D149
介电常数 @1MHz	4.0	ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0×10 ¹²	ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	8.0	ASTM D5470
	8.0	ISO22007
阻燃等级	V-0	UL94 (E331100)

热阻抗



产品型号说明

TIF1	00	N	8085-06	
				颜色: 06 (白色)
				导热系数: 8.0 W/m·K & 硬度: 85
				低介电
				厚度: 12 mils~120 mils
				产品系列

产品规格

标准厚度: 0.012" (0.30 mm) ~ 0.120" (3.00 mm)
标准尺寸: 4.7"×4.7" (120 mm×120 mm)

TIF®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系

全球方案：在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF100N 8085-06-0826